

PAT-NO: JP02002111080A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002111080 A

TITLE: PELTIER MODULE AND
MANUFACTURING METHOD THEREFOR

PUBN-DATE: April 12, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OKADA, HIROAKI

N/A

INT-CL (IPC): H01L035/32, H01L035/34

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a durable Peltier module where a crack or the like is hard to occur at a junction part or a P- or N-type thermoelectric element even if it is repeatedly applied with a thermal stress.

SOLUTION: A Peltier module is provided where a plurality of P- and N-type thermoelectric elements are provided side by side between a pair of facing substrates 1 and 1', while a P-type thermoelectric element 2 and an N-type thermoelectric element 3 are connected in series through junction electrodes 4 and 4' so provided as to face the substrates 1 and 1'. An array pattern comprises an angular part at its periphery which

comprises the junction
electrodes 4 and 4' provided at the pair of
substrates 1 and 1'. A plurality
of thermoelectric elements having the same
characteristics are jointed to
facing angular-part junction electrodes 4a and 3'a
to form the angular part of
the array pattern.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

DERWENT-ACC-NO: 2002-458665

DERWENT-WEEK: 200249

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Peltier module for cooling
system, has joining electrodes provided on
opposing substrates, to connect
several P-type and N-type
thermoelements of same
characteristic

PRIORITY-DATA: 2000JP-0300176 (September 29, 2000)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PAGES	PUB-DATE
LANGUAGE		MAIN-IPC
JP 2002111080 A		April 12, 2002
N/A	010	H01L 035/32

INT-CL (IPC): H01L035/32, H01L035/34

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2002111080A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The Peltier module has joining electrode (4,4') provided to each pair of opposing substrates to form an array pattern which has an angular portion at is periphery. Several P-type and N-type thermoelements (2,3) of the same characteristic are joined to the angular portion.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is

included for Peltier module
manufacturing method.

USE - For cooling system.

ADVANTAGE - Increase of the bonding surface of a joining electrode and a thermoelement, is achieved thus relaxation of thermal stress to a junction is performed and faults such as a crack is also reduced. Destruction of the junction by disconnection is prevented and high reliability of the module is achieved.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the top view of the Peltier module omitting the upper side substrate.

P-type and N-type thermoelements 2,3

Joining electrodes 4,4'

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-111080

(P2002-111080A)

(43) 公開日 平成14年4月12日 (2002.4.12)

(51) Int. Cl.

H 0 1 L 35/32
35/34

識別記号

F I

H 0 1 L 35/32
35/34

テ-グ-ト* (参考)

A

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2000-300176 (P2000-300176)

(22) 出願日 平成12年9月29日 (2000.9.29)

(71) 出願人 000005832

松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

(72) 発明者 岡田 浩明

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株式会社社内

(74) 代理人 100111556

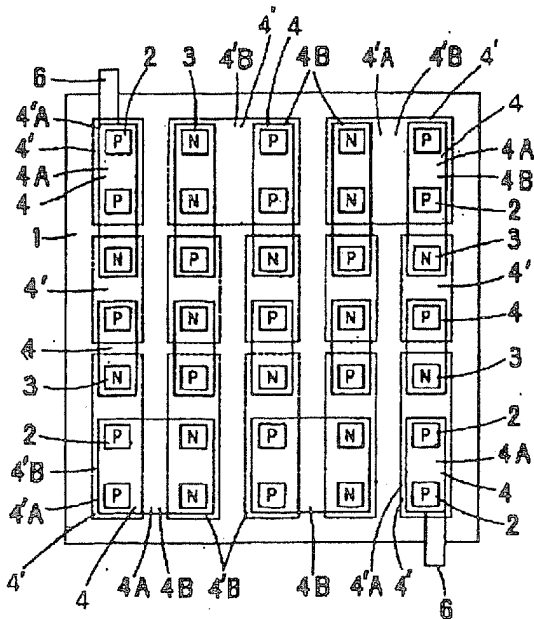
弁理士 安藤 淳二 (外1名)

(54) 【発明の名称】 ベルチェモジュール及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 接合部やP型又はN型の熱電素子に繰り返し熱応力がかかっても、接合部やP型又はN型の熱電素子にクラック等が発生しにくく、耐久性が向上しているベルチェモジュールを提供する。

【解決手段】 対向する一対の基板1、1'間に、P型及びN型熱電素子を複数個並設するとともに、各基板1、1'に対向するように設けている接合電極4、4'を介してP型熱電素子2とN型熱電素子3を直列に接続しているベルチェモジュールであって、一対の基板1、1'のそれぞれに設けている接合電極4、4'で形成される配列パターンが外周に角部を有する配列パターンであり、この配列パターンの角部を形成して対向している角部接合電極4A、4'Aに、同じ特性の熱電素子を複数個接合していることを特徴とするベルチェモジュール。



【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の従来のペルチェモジュールの問題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、熱電素子と接合電極の接合部やP型、N型の熱電素子に繰り返し熱応力がかかっても、接合部やP型、N型の熱電素子にクラック等が発生しにくくて、耐久性が向上しているペルチェモジュール及びその製造方法を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明のペルチェモジュールは、対向する一対の基板間に、P型及びN型熱電素子を複数個並設するとともに、各基板に対向するように設けている接合電極を介してP型熱電素子とN型熱電素子を直列に接続しているペルチェモジュールであって、一対の基板のそれぞれに設けている接合電極で形成される配列パターンが外周に角部を有する配列パターンであり、この配列パターンの角部を形成して対向している角部接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合していることを特徴とするペルチェモジュールである。なお、ここでいう同じ特性については、例えば2個の熱電素子がP型とP型の場合又はN型とN型の場合には同じ特性の熱電素子と表すようにしている。

【0006】この請求項1に係る発明のペルチェモジュールでは、配列パターンの角部を形成して対向している角部接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合する構成を備える。そのために、この発明によれば、熱応力が集中する配列パターンの角部において、複数個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積の増大ができるので、接合部及び熱電素子への熱応力の緩和ができクラック等の不具合を低減できる。また、対向している角部接合電極に接合している複数個の同じ特性の熱電素子中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれるので、断線による破壊を防止できる。従って、この発明によれば、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールを構成することができるようになる。

【0007】請求項2に係る発明のペルチェモジュールは、上記配列パターンが略四角形状であることを特徴とする請求項1記載のペルチェモジュールである。

【0008】この請求項2に係る発明のペルチェモジュールは、接合電極で形成される配列パターンが略四角形状であるので、他の形状に比べて、ペルチェモジュールを容易に作製できるという利点がある。

【0009】請求項3に係る発明のペルチェモジュールは、上記配列パターンが略長方形形状であり、この配列パターンの長辺側の外周部を形成して対向している長辺側外周部接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合していることを特徴とする請求項1又は請求項2記載のペルチェモジュールである。

【0010】この請求項3に係る発明のペルチェモジュールでは、角部接合電極に加えて、長辺側外周部接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合している。従って、この発明によれば、熱応力が集中する配列パターンの角部及び長辺側外周部において、複数個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積の増大ができるので、接合部及び熱電素子への熱応力の緩和ができクラック等の不具合を低減できる。また、対向している角部接合電極及び対向している長辺側

外周部接合電極に接合している複数個の同じ特性の熱電素子中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれるので、断線による破壊を防止できる。従って、この発明によれば、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールを構成することができるようになる。

【0011】請求項4に係る発明のペルチェモジュールは、P型熱電素子とN型熱電素子とを接合電極を介して直列に接続している平面状の回路パターンの折返し部となる位置にあって、対向している接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合していることを特徴とする請求項1〜請求項3の何れかに記載のペルチェモジュールである。

【0012】この請求項4に係る発明のペルチェモジュールでは、角部接合電極に加えて、P型熱電素子とN型熱電素子とを接合電極を介して直列に接続している平面状の回路パターンの折返し部となる位置にあって、対向している接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合している構成を備えている。従って、この発明によれば、熱応力が集中する配列パターンの角部及び回路パターンの折返し部において、複数個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積の増大ができるので、接合部及び熱電素子への熱応力の緩和ができクラック等の不具合を低減できる。また、対向している角部接合電極及び折返し部となる位置にあって対向している接合電極に接合している複数個の同じ特性の熱電素子中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれるので、断線による破壊を防止できる。従って、この発明によれば、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールを構成することができるようになる。

【0013】請求項5に係る発明のペルチェモジュールの製造方法は、断面が略四角形の棒状の熱電素子材を、一方の基板上的複数の接合電極にまたがらせて接合し、その後、棒状の熱電素子材を切断して個々に分離した熱電素子とし、次いで他方の基板上的接合電極を個々に分離した前記熱電素子と接合してなるペルチェモジュールの製造方法であって、請求項2又は請求項3記載のペルチェモジュールを製造するに際して、一方の基板の接合電極で形成する配列パターンの相対する一対の辺の一方側の外周部を形成している外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する棒状の熱電素子材として、複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材を使用していることを特徴とするペルチェモジュールの製造方法である。

【0014】この請求項5に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、請求項2又は請求項3記載のペルチェモジュールを製造するに際して、基板上の外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する棒状の熱電素子材として、複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材を使用するようにしているので、非常に簡便に請求項2又は請

求項3記載のペルチェモジュールを製造することが可能となる。

【0015】請求項6に係る発明のペルチェモジュールの製造方法は、使用する同じ特性の棒状の熱電素子材が、全て断面形状が同一であることを特徴とする請求項5記載のペルチェモジュールの製造方法である。

【0016】この請求項6に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、使用する同じ特性の棒状の熱電素子材が、全て断面形状が同一であるので、新たな形状の熱電素子材を準備することなしに、請求項2又は請求項3記載のペルチェモジュールを製造することが可能となる。

【0017】請求項7に係る発明のペルチェモジュールの製造方法は、使用する断面が略四角形の棒状の熱電素子材の高さが全て等しくて、一方の基板の接合電極で形成する配列パターンの相対する一対の辺の一方側の外周部を形成している外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の中の最外周側のもの幅が、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅より大きいことを特徴とする請求項5記載のペルチェモジュールの製造方法である。

【0018】この請求項7に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の中の最外周側のもの幅を、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅より大きくしているため、熱応力が集中する配列パターンの角部及び外周部において、接合電極と熱電素子の接合面積や熱電素子のトータルの断面面積を大きくしているペルチェモジュールを製造することができ、従って、接合部及び熱電素子にクラック等が発生しにくくて、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールを製造することができるようになる。なお、ここでいう高さとは、基板上に断面が略四角形の棒状の熱電素子材を横設したときの高さと幅を表している。

【0019】請求項8に係る発明のペルチェモジュールの製造方法は、使用する断面が略四角形の棒状の熱電素子材の高さが全て等しくて、一方の基板の接合電極で形成する配列パターンの相対する一対の辺の一方側の外周部を形成している外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の幅の合計寸法が、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅と同じであることを特徴とする請求項5記載のペルチェモジュールの製造方法である。

【0020】この請求項8に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の

幅の合計寸法を、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅と同じにしているため、P-N対の素子断面面積に関して、複数本の棒状の熱電素子材を接合電極に接合して製造される外周部と、1本の棒状の熱電素子材を接合電極に接合して製造される中央部とで同じにできるので、外周部での吸熱量の低下を生じさせることなく、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールを製造することができるようになる。

【0021】請求項9に係る発明のペルチェモジュールの製造方法は、一方の基板の接合電極で形成する配列パターンの相対する一対の辺の一方側の外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材と、前記一対の辺の他方側の外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材が、共に同じ特性の熱電素子材であることを特徴とする請求項5～請求項8の何れかに記載のペルチェモジュールの製造方法である。

【0022】この請求項9に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、配列パターンの相対する一対の辺の両方の外周部接合電極の外周側に同じ特性の棒状の熱電素子材を配設するので、強度的に両辺が均等になり、より品質が安定したペルチェモジュールを得ることが可能となる。

【0023】請求項10に係る発明のペルチェモジュールの製造方法は、請求項9記載のペルチェモジュールの製造方法における、外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の特性が全てP型であることを特徴とするペルチェモジュールの製造方法である。

【0024】この請求項10に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の特性が全てP型である。そして、P型の熱電素子材の方が、N型のものより一般的に高強度であるため、この発明のペルチェモジュールの製造方法によれば、より耐久性が良好なペルチェモジュールを得ることが可能となる。

【0025】

【発明の実施の形態】以下に本発明のペルチェモジュールに関する実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0026】図1は本発明のペルチェモジュールの一実施の形態（第1実施形態）を説明するための上側基板1'を省略した平面図である。この第1実施形態では、図1に示すように、対向する一対のアルミナ等のセラミックよりなる上下の基板1、1'間に（上側基板1'は図に表れていない）、P型熱電素子2及びN型熱電素子3を複数個並設している。各基板1、1'には対向するように接合電極4、4'を設けていて、図1では、下側基板1に設けている下側接合電極4は実線の枠で示し、

上側基板1' (図に表れていない)の下面に設けている上側接合電極4'は破線の枠で示している。図1に示すように、下側基板1に備えた下側接合電極4と、上側基板1'に設けた上側接合電極4'とが対向している位置に、P型熱電素子2又はN型熱電素子3が接合されていて、下側接合電極4又は上側接合電極4'を介してP型熱電素子2とN型熱電素子3を直列に接続するようにしている。なお、図1において、符号6はリード線を示す。また、図1中でP型熱電素子2にはP、N型熱電素子3にはNの記号を付している。

【0027】そして、下側接合電極4と、上側接合電極4'で形成される配列パターンのそれぞれは、図1に示すように、四角形状であり、ペルチェ効果を発するP型熱電素子2とN型熱電素子3は、5(列)×5(列)が、下側接合電極4又は上側接合電極4'を介して直列接続されている。ここでは、対向する接合電極4、4'に同一特性の熱電素子が2個接合されていても、直列接続されている列数は1としている。そして、下側接合電極4と、上側接合電極4'でそれぞれ四角形状に形成されている配列パターンの角部を形成して対向している角部接合電極4Aと、4'Aに、同じ特性の熱電素子を2個接合している。また、図1に示す下側接合電極4と、上側接合電極4'でそれぞれ形成されている配列パターンでは、P型熱電素子2とN型熱電素子3とを接合電極(4又は4')を介して直列に接続している平面状の回路パターンの折返し部となる位置が、全て配列パターンの外周部となっている。そして、図1に示すように、第1実施形態では平面状の回路パターンの折返し部となる位置にあって、対向している外周部接合電極4B、4'Bにも、同じ特性の熱電素子を2個接合している。なお、一部の角部接合電極4A、4'Aは、平面状の回路パターンの折返し部となる位置にあって、対向している外周部接合電極4B、4'Bにも相当している。

【0028】そして、各熱電素子2、3の接合電極4、4'との接合面積は全て同じとし、同じ特性の熱電素子を2個接合している接合電極の面積は、同じ特性の熱電素子はそれぞれ1個のみしか接合していない接合電極の面積より大きくしている。

【0029】この第1実施形態では、対向している角部接合電極4A、4'A及び平面状の回路パターンの折返し部となる位置にあって、対向している外周部接合電極4B、4'Bに同じ特性の熱電素子を2個接合すると共に、同じ特性の熱電素子を2個接合している接合電極の面積は、同じ特性の熱電素子はそれぞれ1個のみしか接合していない接合電極の面積より大きくしている。そのため、熱応力が集中する配列パターンの角部及び回路パターンの折返し部において、2個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積が増大している。さらに、同じ特性の熱電素子2個中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれる

ようになっている。従ってこの第1実施形態のペルチェモジュールは、接合部及び熱電素子にクラック等の不具合が発生しにくくて、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールとなる。

【0030】なお、図示しないが、回路パターンの折返し部を、配列パターンの外周部とせず、配列パターンの中間位置に設けるようにすることもこの第1実施形態の変形した形態として可能である。

【0031】次に、図2は本発明のペルチェモジュール異なる実施の形態(第2実施形態)を説明するための上側基板1'を省略した平面図である。この第2実施形態では、図2に示すように、対向する一対のアルミナ等のセラミックよりなる上下の基板1、1'間(上側基板1'は図に表れていない)に、P型熱電素子2及びN型熱電素子3を複数個並設している。各基板1、1'には対向するように接合電極4、4'を設けていて、図2では、下側基板1に設けている下側接合電極4は実線の枠で示し、上側基板1' (図に表れていない)の下面に設けている上側接合電極4'は破線の枠で示している。図2に示すように、下側基板1に備えた下側接合電極4と、上側基板1'に設けた上側接合電極4'とが対向している位置に、P型熱電素子2又はN型熱電素子3が接合されていて、下側接合電極4又は上側接合電極4'を介してP型熱電素子2とN型熱電素子3を直列に接続するようにしている。なお、図2において、符号6はリード線を示す。また、図2中でP型熱電素子2にはP、N型熱電素子3にはNの記号を付している。

【0032】そして、下側接合電極4と、上側接合電極4'で形成される配列パターンのそれぞれは、図2に示すように、この第2実施形態では、長方形である。それらの配列パターンの角部を形成して対向している角部接合電極4Aと、4'Aに、同じ特性の熱電素子を2個又は4個接合している。また、下側接合電極4と、上側接合電極4'でそれぞれ形成される配列パターンの長辺側の外周部を形成して対向している長辺側外周部接合電極4Bと4'Bにも、同じ特性の熱電素子を2個又は4個接合している。なお、角部接合電極4A、4'Aは、長辺側外周部接合電極4B、4'Bにも相当している。そして、各熱電素子2、3の接合電極4、4'との接合面積は全て同じとし、同じ特性の熱電素子を2個又は4個接合している接合電極の面積は、同じ特性の熱電素子はそれぞれ1個のみしか接合していない接合電極の面積より大きくしている。

【0033】この第2実施形態では、対向している角部接合電極4A、4'A及び対向している外周部接合電極4B、4'Bに同じ特性の熱電素子を複数個接合すると共に、角部接合電極4A、4'A及び外周部接合電極4B、4'Bの面積は、同じ特性の熱電素子はそれぞれ1個のみしか接合していない接合電極の面積より大きくしている。そのため、熱応力が集中する配列パターンの角

部及び長辺側外周部において、複数個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積が増大している。さらに、複数個の同じ特性の熱電素子中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれるようになっている。従って、この第2実施形態のペルチェモジュールは、接合部及び熱電素子にクラック等の不具合が発生しにくくて、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールとなる。

【0034】また、第2実施形態では、P型熱電素子2とN型熱電素子3とを接合電極(4又は4')を介して直列に接続している平面状の回路パターンの折返し部となる位置にあって、対向している接合電極は、配列パターンの長辺側の外周部を形成して対向している外周部接合電極4Bと4'Bに相当することになり、熱応力が集中する回路パターンの折返し部についても、耐久性が向上する構成になっていることになる。

【0035】次に、本発明のペルチェモジュールの製造方法に関する実施形態を説明する。

【0036】上述した図2に示す、第2実施形態のペルチェモジュールの製造方法について説明する。まず、図3に示すように、下側接合電極4を固着しているアルミナ等のセラミックよりなる下側基板1を準備する。なお、下側接合電極4は、例えば銅板等の金属板で形成する。次いで、図4に示すように、四角柱状であって、断面形状が同一であるP型及びN型の棒状の熱電素子材7、8を、下側基板1上の複数の下側接合電極4にまたがらせて配設し、次いで接合する。この場合の接合は、例えば下側接合電極4の所定位置に半田ペーストを塗布しておき、加熱する方法等によって行うことができる。棒状の熱電素子材7、8の配置については、下側接合電極4で形成する配列パターン(長方形)の相対する長辺の一方側の外周部を形成している外周部接合電極4B、4B、...の外周側にまたがらせて、2本のP型熱電素子材7を配置している。そして、配列パターンの相対する長辺の他方側の外周部を形成している外周部接合電極4B、4B、...の外周側にまたがらせて、同様に2本のP型熱電素子材7を配置している。そして、上記の外周部接合電極4B、4B、...の内側に独立している接合電極4には、棒状のP型熱電素子材7及び棒状のN型熱電素子材8を各1本接合している。

【0037】このように、配列パターンの相対する長辺の両方側の外周部接合電極4B、4B、...の外周側に、2本の同じ特性(この場合はP型)であって、同形状の熱電素子材を配設するようにすると、強度的に両辺が均等になり、より品質が安定したペルチェモジュールを得ることが可能となる。また、P型の熱電素子材の方が、N型のものより一般的に高強度なので、このように外周部接合電極4B、4B、...の外周側に配設する2本の同じ特性の棒状の熱電素子材についてその特性をP型とすると、より耐久性が良好なペルチェモジュールを得ること

とができる利点がある。

【0038】次いで、下側基板1上の下側接合電極4に接合した棒状のP型及びN型熱電素子材7、8をワックスで固定した後、図4に示す複数の切断刃を有する切断部材9で、各熱電素子材7、8の所定位置を切断し、ワックスを洗浄除去して、図5に示すように個々に分離した熱電素子(P型熱電素子2又はN型熱電素子3)を下側接合電極4に接合した下側基板1を得る。次いで、予め準備しておいたアルミナ等のセラミックよりなる上側基板1'(図示せず)に形成している上側接合電極4'と下側基板1上の各熱電素子2、3とを、例えば半田ペースト等を用いて接合して図2に示す、第2実施形態のペルチェモジュールを作製する。

【0039】このように、この製造方法に関する実施形態では、断面が四角形の棒状のP型熱電素子材7及びN型熱電素子材7を原材料として用い、且つ下側基板1上の外周部接合電極4Bの外周側にまたがらせて接合する熱電素子材として、2本の同じ特性の棒状の熱電素子材を使用するようにしているので、非常に簡便に図2に示す、第2実施形態のペルチェモジュールを製造することが可能となる。

【0040】また、下側接合電極4で形成する配列パターン(長方形)の相対する一対の辺である、長辺の一方側の外周部を形成している外周部接合電極4B、4B、...の外周側にまたがらせて、断面が四角形であって、高さが等しい2本の棒状のP型熱電素子材7を配置する場合に、図6に示すように、最外周側に配置するP型熱電素子材7の幅を、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極4に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅より大きくすることもできる。ここでいう接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極4とは、図6に示すように、外周部接合電極4B、4B、...の内側にある接合電極4である。このように、最外周側に配置するP型熱電素子材7の幅を、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極4に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅より大きくすると、熱応力が集中する配列パターンの角部及び外周部において、接合電極と熱電素子の接合面積や熱電素子のトータルの断面積(基板面と平行する方向の断面積)を大きくしているペルチェモジュールを製造できるため、接合部及び熱電素子にクラック等が発生しにくくて、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールを製造することができるようになる。

【0041】また、ペルチェモジュールを製造するに際して、図7に示すように、下側接合電極4で形成する配列パターン(長方形)の相対する一対の辺である、長辺の一方側の外周部を形成している外周部接合電極4B、4B、...の外周側にまたがらせて配置する、断面が四角形であって、高さが等しい2本の同じ特性(この場

合はP型)の棒状の熱電素子材の幅の合計寸法を、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極4に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅と同じにすることもできる。ここでいう接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極4とは、図7に示すように、外周部接合電極4B、4B、…の内側にある接合電極4である。このようにすると、P-N対の素子断面面積に関して、複数本の棒状の熱電素子材を接合電極に接合して製造される外周部と、1本の棒状の熱電素子材を接合電極に接合して製造される中央部とで同じにできるので、外周部での吸熱量の低下を生じさせることなく、信頼性の高い、耐久性が向上したベルチェモジュールを製造することができるようになるという利点がある。

【0042】

【発明の効果】請求項1に係る発明のベルチェモジュールでは、配列パターンの角部を形成して対向している角部接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合する構成を備える。そのために、この請求項1に係る発明によれば、熱応力が集中する配列パターンの角部において、複数個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積の増大ができるので、接合部及び熱電素子への熱応力の緩和ができクラック等の不具合を低減できる。また、対向している角部接合電極に接合している複数個の同じ特性の熱電素子中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれるので、断線による破壊を防止できる。従って、この請求項1に係る発明によれば、信頼性の高い、耐久性が向上したベルチェモジュールを構成することができるようになる。

【0043】請求項2に係る発明のベルチェモジュールは、接合電極で形成される配列パターンが略四角形状であるので、請求項1に係る発明の効果に加えて、ベルチェモジュールの作製が容易になるという効果を奏する。

【0044】請求項3に係る発明のベルチェモジュールでは、角部接合電極に加えて、長辺側外周部接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合している。従って、この請求項3に係る発明によれば、熱応力が集中する配列パターンの角部及び長辺側外周部において、複数個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積の増大ができるので、接合部及び熱電素子への熱応力の緩和ができクラック等の不具合を低減できる。また、対向している角部接合電極及び対向している長辺側外周部接合電極に接合している複数個の同じ特性の熱電素子中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれるので、断線による破壊を防止できる。従って、この請求項3に係る発明によれば、信頼性の高い、耐久性が向上したベルチェモジュールを構成することができるようになる。

【0045】請求項4に係る発明のベルチェモジュールでは、角部接合電極に加えて、P型熱電素子とN型熱電

素子とを接合電極を介して直列に接続している平面状の回路パターンの折返し部となる位置にあって、対向している接合電極に、同じ特性の熱電素子を複数個接合している構成を備えている。従って、この請求項4に係る発明によれば、熱応力が集中する配列パターンの角部及び回路パターンの折返し部において、複数個の熱電素子による荷重分担ができると共に、接合電極と熱電素子の接合面積の増大ができるので、接合部及び熱電素子への熱応力の緩和ができクラック等の不具合を低減できる。また、対向している角部接合電極及び折返し部となる位置にあって対向している接合電極に接合している複数個の同じ特性の熱電素子中の1個の熱電素子が破壊しても他の熱電素子で導通がとれるので、断線による破壊を防止できる。従って、この請求項4に係る発明によれば、信頼性の高い、耐久性が向上したベルチェモジュールを構成することができるようになる。

【0046】請求項5に係る発明のベルチェモジュールの製造方法では、請求項2又は請求項3記載のベルチェモジュールを製造するに際して、基板上の外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する棒状の熱電素子材として、複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材を使用しているようにしているので、非常に簡便に請求項2又は請求項3記載のベルチェモジュールを製造することが可能となる。

【0047】請求項6に係る発明のベルチェモジュールの製造方法では、使用する同じ特性の棒状の熱電素子材が、全て断面形状が同一であるので、新たな形状の熱電素子材を準備することなしに、請求項2又は請求項3記載のベルチェモジュールを製造することが可能となる。

【0048】請求項7に係る発明のベルチェモジュールの製造方法では、外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の中の最外周側のもの幅を、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅より大きくしていることで、熱応力が集中する配列パターンの角部及び外周部において、接合電極と熱電素子の接合面積や熱電素子のトータルの断面面積を大きくしているベルチェモジュールを製造することができ、従って、接合部及び熱電素子にクラック等が発生しにくくて、信頼性の高い、耐久性が向上したベルチェモジュールを製造することができるようになる。

【0049】請求項8に係る発明のベルチェモジュールの製造方法では、外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の幅の合計寸法を、接合される同じ特性の棒状の熱電素子材は1本のみである接合電極に配設される同じ特性の棒状の熱電素子材の幅と同じにしていることで、P-N対の素子断面面積に関して、複数本の棒状の熱電素子材を接合電極に接合して製造される外周部と、1本の棒状の熱電素子材を接合電極に接合して製造される中央部とで同じにで

きるので、外周部での吸熱量の低下を生じさせることなく、信頼性の高い、耐久性が向上したペルチェモジュールを製造することができるようになる。

【0050】請求項9に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、配列パターンの相対する一対の辺の両方の外周部接合電極の外周側に同じ特性の棒状の熱電素子材を配設するので、強度的に両辺が均等になり、より品質が安定したペルチェモジュールを得ることが可能となる。

【0051】請求項10に係る発明のペルチェモジュールの製造方法では、外周部接合電極の外周側にまたがらせて接合する複数本の同じ特性の棒状の熱電素子材の特性が全てP型である。そして、P型の熱電素子材の方が、N型のものより一般的に高強度であるため、この請求項10に係る発明のペルチェモジュールの製造方法によれば、より耐久性が良好なペルチェモジュールを得ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のペルチェモジュールの第1実施形態を説明するための上側基板を省略した平面図である。

【図2】本発明のペルチェモジュールの第2実施形態を説明するための上側基板を省略した平面図である。

【図3】本発明の製造方法を説明するための図であって、下側接合電極を固着している下側基板を示す平面図

である。

【図4】本発明の製造方法を説明するための図であって、棒状の熱電素子材の配設状態を示す平面図である。

【図5】本発明の製造方法を説明するための図であって、切断部材で熱電素子材の所定位置を切断した状態を示す平面図である。

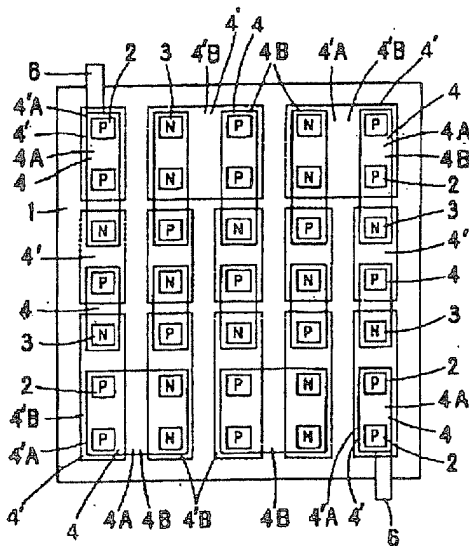
【図6】本発明の製造方法を説明するための図であって、棒状の熱電素子材の異なる配設状態を示す平面図である。

10 【図7】本発明の製造方法を説明するための図であって、棒状の熱電素子材のさらに異なる配設状態を示す平面図である。

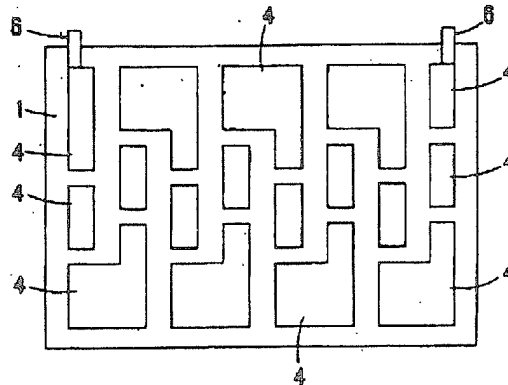
【符号の説明】

- 1、1' 基板
- 2 P型熱電素子
- 3 N型熱電素子
- 4、4' 接合電極
- 4A、4' A 角部接合電極
- 4B、4' B 外周部接合電極
- 6 リード線
- 7 P型熱電素子材
- 8 N型熱電素子材
- 9 切断部材

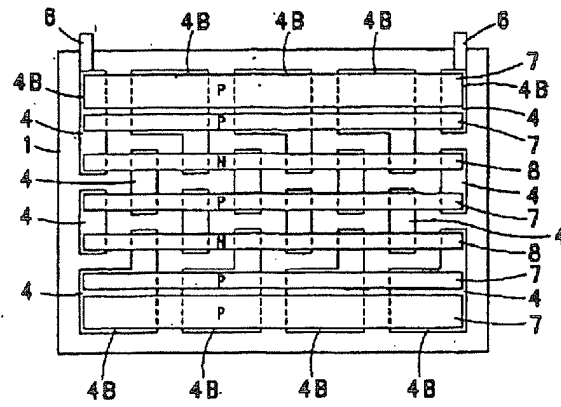
【図1】



【図3】



【図6】



【図7】

